

報道関係各位

2019 年 5 月 27 日
株式会社タムラ製作所

第49回国際電子回路産業展（JPCA Show 2019）
第21回実装プロセステクノロジー展（JISSO PROTEC 2019）
タムラ製作所のみどころ

株式会社タムラ製作所（本社：東京都練馬区、代表取締役社長：浅田昌弘）は、6月5日（水）～7日（金）まで東京ビックサイトで開催される第49回国際電子回路産業展（JPCA Show 2019）と第21回実装プロセステクノロジー展（JISSO PROTEC 2019）に出展致します。

電子化学事業のオリジンとなった酸化防止剤の技術をベースにした接合材と独自開発した樹脂を使用した絶縁材の他、実装設備は、炉内の汚れを大幅に低減し、飛躍的にメンテナンスサイクルの延長・改善を実現するリフローTNV Version IIIを、それぞれのお客様のニーズに合わせた形で提案します。

【主な出展製品のご案内】

第49回国際電子回路産業展（JPCA Show 2019）ブース番号 4-208（西4階）



〈絶縁材〉

・高信頼性写真現像型液状ソルダーレジスト「DSR-2200ACR シリーズ」

次世代車載基板に要求される過酷環境下での耐塗膜クラック性、耐熱性、絶縁信頼性、密着性等の長期信頼性に優れた高機能ソルダーレジストです。ハロゲンフリー。セミマットタイプ有り。

・DI 露光対応 リジット基板用黒色液状ソルダーレジスト「APB-200 シリーズ」

高感度、高解像性を備えた DI 露光対応のソルダーレジストでお客様の生産性向上に貢献します。各種基板作製工程の影響を最小限に抑えた超低光沢タイプや微細なソルダーダムの形成性能に優れたタイプを取り揃えております。

・黒色吸収材 フレキシブル基板用黒色液状ソルダーレジスト「APB-300 シリーズ、APB-280 シリーズ」
高い柔軟性を有した DI 露光対応のソルダーレジストです。各種フレキシブル基板、リジットフレキシ基板のみならず、Mini LED や Micro LED など次世代ディスプレイの隔壁用途にも提案しております。

・白色反射材 フレキシブル基板用白色液状ソルダーレジスト「RPW-300」

先進樹脂設計技術により優れた折り曲げ性能、高反射率、高解像性、低露光量を実現した白色ソルダーレジストです。Mini LED バックライト基板などの次世代ディスプレイ用途や高意匠性車載 LED 用途に適しております。

・フレキシブル基板用高絶縁信頼性・低反発 solder レジスト「PAF-800-17A」「E852-800-17A」
優れた柔軟性と高絶縁信頼性を持ち合わせたフレキシブル基板向け solder レジストです。EMI シールドフィルムへの貼り付けが可能であり、部品実装部と配線部へのカバーレイ一括形成を提案致します。一括形成による製造工程の削減、並びにベゼルレスディスプレイに要求される基板の薄膜化や組込み時の形状保持（低反発特性）を実現します。液状とドライフィルムを取り揃えております。

・インクジェット用 solder レジスト「JIM シリーズ」
従来の写真現像プロセスに対し、現像工程削減による環境負荷の低減、省スペース化を実現します。各種基材との密着性が優れたフレキシブル基板用を開発。

第 21 回実装プロセステクノロジー展（JISSO PROTEC 2019）ブース番号 1-104（西 1 階）



〈実装装置〉

・リフロー TNV Version III

実装設備は、炉内の汚れを大幅に低減し、飛躍的にメンテナンスサイクルの延長・改善を実現する TNV Version III を出展致します。最新の革新技术により、生産機会損失を大幅に低減します。



〈接合材〉

・高耐熱 Pb フリー合金「#287」

HV、EV 化に伴い ECU/PCU では、より一層厳しいヒートサイクル基準が求められます。従来の車載市場で長い実績を有する SAC305 では、 $-40 \leftrightarrow 125^{\circ}\text{C}/3000\text{Cycles}$ の要求に応えるには限界が来ております。弊社が新規開発した合金組成を使用することで、 $-40 \leftrightarrow 125^{\circ}\text{C}/3000\text{Cycles}$ にて SAC305 比較ではんだ接合部に発生する亀裂進展を大幅に抑制することが可能になりました。

・高信頼性 solder ペースト「TLF-204-203」

マイグレーション発生原因となりえるフラックス残さのクラックを抑制した従来品から、更に、はんだ濡れ性、ボイド発生率、印刷安定性などすべて面においてレベルアップを図りました。また、基板実装効率化のため車載機器分野でも導入が進んでいるスルーホールリフロー工法においても、solder ペーストの垂れ落ちの発生を抑え、効率的かつ高品質な基板実装が可能です。

・一般実装向け Pb フリー solder ペースト「TLF-204 シリーズ」

実装業界では放熱改善のための QFN 下面電極(e-Pad)のボイド低減や BGA の未融合改善、酸化が進行した電子部品への濡れ性の確保等、多種多様な要求がお客様から寄せられてきております。弊社 TLF-204 シリーズでは各種問題解決となるべく製品ラインナップを取りそろえ、それらの要求にこたえていきま

す。

・ジェットディスペンス対応ソルダーペースト「JDS シリーズ」

既存の印刷工法では位置合わせの難しいFPC基板、印刷難度の高いキャビティを有する基板、立体的な基板のはんだ付といった用途において、非接触のはんだ塗布としてジェットディスペンス工法の適用が検討されています。「JDS シリーズ」は、塗布径に合わせて SAC305 として 2 種のソルダーペーストを製品ラインナップ化し、ジェットディスペンスにおける吐出安定性と飛び散り(サテライト)低減に対応しています。

・局所加熱対応ソルダーペースト「LSM シリーズ」

半田ごてを用いた手付けはんだ付け法では、はんだ量の調整が困難になっています。高まる品質向上の要求に伴い、弊社では手付けはんだ付け法の代替となる製品として、「LSM シリーズ」を提案いたします。当製品は、ディスペンサーでのペーストの塗布安定性が優れており、レーザーやハロゲンランプといった急速加熱によるフラックスの飛散の発生が少ないため、局所・急速加熱はんだ付けに対応した製品となっております。

【展示会情報】

第 49 回国際電子回路産業展 (JPCA Show 2019)

会期：2019 年 6 月 5 日 (水) ～7 日 (金) 10:00～17:00 (最終日のみ 16:00 まで)

会場：東京ビッグサイト ブース番号 4-208 (西 4 階)

第 21 回実装プロセステクノロジー展 (JISSO PROTEC 2019)

会期：2019 年 6 月 5 日 (水) ～7 日 (金) 10:00～17:00 (最終日のみ 16:00 まで)

会場：東京ビッグサイト ブース番号 1-104 (西 1 階)

■ 本件に関する問い合わせ先

株式会社タムラ製作所 経営管理本部 経営支援グループ TEL03-3978-2031